

Press Release

2025 年 7 月 29 日

報道関係者各位

サンディスク、高帯域幅フラッシュメモリー技術の開発と戦略を支援する HBF™技術諮問委員会を設立

サンディスク コーポレーション (NASDAQ: SNDK) は 7 月 24 日、革新的な高帯域幅フラッシュ (HBF™) メモリー技術の開発と戦略を手引する技術諮問委員会の設立を発表しました。委員会には、社内外の業界エキスパートやシニア技術リーダーらが名を連ねています。本日任命された David Patterson (デイビッド・パターソン) 名誉教授と Raja Koduri (ラジャ・コドゥリ) 氏は、サンディスクが HBF のローンチに向けて準備するにあたり、戦略的指針、技術的な知見、市場の展望などを提供し、オープンスタンダードを形成していきます。

サンディスクのエグゼクティブバイスプレジデント兼最高技術責任者であり、HBF 技術諮問委員会のメンバーでもある Alper Ilkbahar (アルパー・イルクバハル) は次のように述べています。

「このたびは、コンピュータアーキテクチャの専門家として名高いお二人に弊社の技術諮問委員会にご参加いただき、光栄に思います。お二人の数々の経験と戦略的な助言は、今後 AI 業界において HBF をメモリーのスタンダードとして確立する上で大きな役割を果たすことでしょう。これにより私たちは、顧客やパートナーの期待に応えるだけでなく、それを越えることをお約束します」

[カリフォルニア大学バークレー校](#)のコンピュータサイエンス学科の名誉教授であり、Google の著名なエンジニアでもある David Patterson 氏は、当技術諮問委員会を率い、実用的な知見や意思決定に向けてグループを率います。同氏は、プロセッサ設計に革命をもたらした RISC (Reduced Instruction Set Computing) の共同開発者として有名なコンピュータ科学者です。RAID (Redundant Arrays of Inexpensive Disks) や NOW (Networks of Workstations) の開発でも重要な役割を果たしました。また、画期的な教本『Computer Architecture: A Quantitative Approach (コンピュータアーキテクチャ：定量的アプローチ)』の共同執筆者、2017 年には業界への多大な貢献が認められ、ACM チューリング賞を受賞しています。

Patterson 名誉教授は次のように述べています。

「HBF は、高帯域幅でかつてないほどのメモリー容量を提供し、現在の限界をはるかに超えて推論ワークロードの規模を拡大することを可能にするなど、データセンター AI において重要な役割を果たす可能

性を示しています。これにより、現在は高額な新規 AI アプリケーションのコスト削減が進むことが期待できます」

Raja Koduri 氏は、グラフィックスアーキテクチャのリーダーとして有名なコンピューター・エンジニアであり、経営者でもあります。前職の AMD ではシニアバイスプレジデント兼チーフアーキテクトとして Polaris、Vega、Navi GPU アーキテクチャの開発を指揮したほか、Intel では Accelerated Computing Systems and Graphics 事業本部のエグゼクティブバイスプレジデントとして、Intel Arc や Ponte Vecchio GPU の開発を統括し、Intel のディスクリートグラフィックス分野への進出を主導しました。2023 年初頭には、ゲーム、メディア、エンターテインメント向け生成 AI に特化したスタートアップ企業を設立したほか、AI および RISC-V を手掛ける半導体企業、Tenstorrent 社の取締役に加わりました。最近では、Oxmiq Labs 社の創業者兼 CEO、ならびに Mihira Visual Studios 社の共同創業者を務めるかたわら、半導体業界のあちこちで顧問や取締役会メンバーとして活躍し、グラフィックスと AI のイノベーションを推進し続けています。

Koduri 氏は次のように述べています。

「HBF は、高度なモデルをローカルでリアルタイムに実行することを可能にするメモリー容量と帯域幅をデバイスにもたらすことで、エッジ AI に革命を起こします。この技術革新により、インテリジェントエッジアプリケーションの新たな時代が幕を開け、AI 推論の実行方法や場所が根本から変わることでしょう」。

[Future FWD: Sandisk 2025 Investor Day](#) で紹介された HBF は、高帯域幅メモリー（HBM）を AI 推論ワークロード向けに補強すべく設計された画期的なメモリーソリューションで、HBM に匹敵する帯域幅を提供しながら、同等のコストで 8 倍の容量をもたらします。BiCS 技術と CBA ウエハ接合技術に採用した HBF は、独自のスタッキングを活用し、ダイ反りを極めて低く抑えることで 16 個の積層を実現します。このアーキテクチャは、過去 1 年間にわたり収集した AI 業界の主要企業からのフィードバックを参考に開発されました。

HBF について詳しくは、こちらの[ファクトシート](#)をご覧ください。

※本プレスリリースは、2025 年 7 月 24 日（米国時間）に米国で発表されたメディアアラートの抄訳版です。

■サンディスクについて

サンディスク(Nasdaq: SNDK)は、革新的なフラッシュソリューションと高度なメモリー技術を提供し、願望やシーンが交差する瞬間に立ち会い、人々やビジネスが前進し続け、可能性を押し広げる一翼

を担います。[Instagram](#)、[Facebook](#)、[X](#)、[LinkedIn](#)、[YouTube](#)でサンディスクをフォロー、およびInstagramで[TeamSandisk](#)に参加してください。

© 2025 SanDisk Corporation or its affiliates. All rights reserved.

<本件に関する問い合わせ先>

Investors: investors@sandisk.com

Media: mediainquiries@sandisk.com